

住友ベークライト株式会社 2025年3月期第2四半期 決算説明会
主な質疑応答議事録

日時：2024年11月5日（火）15時00分～16時30分

説明者：代表取締役社長執行役員 藤原 一彦

質疑応答では各部門担当役員による補足説明あり

【全社的な事項】

Q：年間300億円の事業利益予想を据え置いており、上期実績との差し引きで下期は減益見通しとなるが、考え方について教えて欲しい。

A：300億円は期初に出した事業利益計画であり、進捗率は既に50%を上回っているのも、もちろん上振れる可能性はある。しかしながら、世界の政局など不透明な部分もあるので、安全を見て据え置いた。300億円は必ず達成したい。

【半導体関連材料セグメント】

Q：地域別、用途別で下期の売上の変化を教えて欲しい。

A：先は読みにくいですが、上期と大きくは変わらないと思う。4Qには中華正月による稼働日減があるものの中国は好調を維持する一方で、台湾や車載半導体中心の東南アジア地区は停滞が続く。九州の工場で生産しているエッジAIに用いられる先端半導体用の顆粒封止材、MUFは下期も期待できる。

Q：決算説明会資料にある“液状封止材の検討を開始”の意味を教えて欲しい。

A：クラウドAIのGPUは液状封止材がメインで、弊社の顆粒封止材は使われていない。顆粒封止材はパッケージの大判化に対して強力な武器となるが、今後エッジAI、クラウドAIの両方が伸びていくことが予想されるので、両方の材料を持っているのが得策と考える。弊社も液状封止材に近い製品を持っているので、その技術の洗い出しと、弊社独自のソリューションを提供できないかの検討を開始した。

Q：パワー半導体、パワーモジュールにおける弊社の強みは何か？

A：決算説明会資料に掲げた半導体関連材料に加え、高機能プラスチックセグメントの材料である放熱材料、液状材料も含めて、セットでOne Sumibeとしてパワー半導体やモジュールの良さを引き出す構造提案ができることが大きな強みであり、差別化できる点である。

Q：今後、特に伸びそうな製品は何か？

A：一番期待しているのはパワーモジュール用の材料である。特にEVを中心に産業機械

でも高出力、省電力の要求が高まる中、SiC が伸びてくると言われている。AI 関連では、エッジ AI が着実に伸びており、採用されるスマホ、PC の機種数、台数が予定通り伸びていけば、来年度は更に期待できる。

【高機能プラスチックセグメント】

Q：北米のレジン関係事業の収益改善策を教えてください。

A：構造改革を進めている。採算が非常に悪い製品については、可能な限り値上げをお願いするなど収益性改善を進める。その過程において事業の縮小もやむを得ない。また、環境対応製品のようなオンリーワン製品をいかに早く上市できるかが重要である。

Q：米系航空機会社のストの弊社航空機内装部品事業への影響はどうか？

A：一時的に売上が減っているが、それに合わせて生産の体制も落としてコスト削減を進め、下期も上期並みの利益を確保するよう努める。

【クオリティオブライフ関連製品】

Q：上期の利益進捗率が高いが、期初の想定と何が違うのか？

A：フィルムシートで、半導体の需要が戻ってきており、当社の強みである半導体用のカバーテープが回復しており、中国のお客様で採用が進んだ。また、医療機器で一部の海外顧客から前倒し販売の要請があり対応した。

以上